

中華民國資訊軟體服務商業同業公會 函

地址：台北市中山區長安東路二段101號8樓

承辦人：黃韻靜

聯絡方式：02-2553-3988分機829

傳真：02-2553-1319

電子信箱：abby.huang@tissa.org.tw

受文者：長庚學校財團法人長庚科技大學

發文日期：中華民國115年9月29日

發文字號：資軟字第1150000368號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：【2026創新資訊應用展示暨研討會】報名簡章、EDM

(DOC022600505_1150000368_1046_ATTACH1.pdf、

DOC022600505_1150000368_1046_ATTACH2.png)

主旨：敬邀 貴單位資訊、採購及業務相關人員參加「2026創新資訊應用展示暨研討會」，掌握AI、資安雲端、智慧治理及創新應用等最新趨勢，並與共同供應契約廠商交流資訊解決方案；活動免費報名並認列公務人員學習時數，敬請公告週知並踴躍參加。

說明：

一、「創新資訊應用展示暨研討會」自2016年起持續串聯政府機關與資訊產業，長期推動「電腦軟體共同供應契約」之資訊應用交流，協助機關及學校於採購前進一步了解廠商產品之內容、功能及服務，促進資訊應用交流與產業合作，敬請貴單位資訊、採購及業務相關人員踴躍報名參加。

二、旨揭活動將於北、中、南三區舉辦，提供各機關人員選擇便利場次參與：

(一)活動主場：台北場—10月30日(星期五)09:30至16:00，

電子文
騎

8

假臺大醫院國際會議中心2F（台北市中正區徐州路2號2樓）

（二）巡迴場：高雄場—10月23日（星期五）13:30至17:00，假亞灣新創園3F（高雄市前鎮區成功二路25號3樓）

（三）巡迴場：台中場—11月06日（星期五）13:30至17:00，假思享空間2F（台中市東區公園東路130號2樓）

三、今年以「The AI Nexus：智鏈賦能·驅動未來」為活動主軸，台北主場首次以大型 AI 解方博覽會形式擴大展出，匯聚 63 家次廠商，聚焦「智慧治理」、「AI人工智慧」、「資安雲端」及「創新應用」四大領域，展示多元資訊解決方案與實務案例；並延續政府共同供應契約廠商參展特色，設置「智慧治理專區」，集中展示共契產品與解決方案，提供機關、學校、醫療院所及公股銀行等單位瞭解產品功能、服務內容及實際應用。

四、各場次規劃主題論壇及實務分享，提供與會人員掌握最新產業趨勢與資訊應用發展；台北場另設「InfoSec 信任×防護」及「AI 未來∞創新」雙軌論壇，可依需求選擇議題參與，詳細議程請參閱附件簡章。

五、本活動設有公務機關專屬媒洽服務，機關人員可於活動前預約欲洽詢之廠商及方案，並於活動當日完成媒合，即可獲得媒洽專屬好禮，提升機關與廠商交流媒合效率，預約方式請參閱附件簡章。

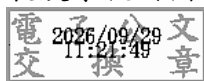
六、台北主場另提供團體展示導覽，由專人帶領參觀展示區，協助快速瞭解展會重點及多元解決方案；本活動採免費報名並認列公務人員學習時數，詳細活動及報名資訊請參閱

附件簡章，歡迎踴躍參加，額滿為止。（報名網址：

<https://www.tissa.org.tw/Course/Detail/6044>）

正本：長庚學校財團法人長庚科技大學

副本：



裝



訂

線